



中华人民共和国国家标准

GB/T 18500.2—2001
idt IEC 748-4-2:1993
QC 790304

半导体器件 集成电路 第4部分：接口集成电路 第二篇：线性模拟/数字转换器(ADC) 空白详细规范

Semiconductor devices—Integrated circuits—
Part 4: Interface integrated circuits—
Section 2: Blank detail specification for linear
analogue-to-digital converters(ADC)

2001-11-05 发布

2002-06-01 实施

中华人民共和国
国家质量监督检验检疫总局 发布

前 言

本标准等同采用国际电工委员会(IEC)标准 IEC 748-4-2:1993《半导体器件 集成电路 第4部分:接口集成电路 第二篇:线性模拟/数字转换器(ADC)空白详细标准》,以促进我国该类产品的国际贸易、技术和经济交流。

本标准可作为编制线性 ADC 详细规范的依据。

本标准引用了下列标准:

GB/T 4937—1995 半导体器件 机械和气候试验方法(idt IEC 749:1984)

GB/T 16464—1996 半导体器件 集成电路 第1部分:总则(idt IEC 748-1:1984)

GB/T 17573—1998 半导体器件 分立器件和集成电路 第1部分:总则(idt IEC 747-1:1983)

IEC 68-2-17:1978 环境试验 第2部分:试验——试验 Q 密封修改单 4(1991)

IEC 747-10:1991 半导体器件 第10部分:分立器件和集成电路总规范

IEC 748-4:1987 半导体器件 集成电路 第4部分:接口集成电路修改单(1991)

IEC 748-11:1990 半导体器件 集成电路 第11部分:半导体集成电路(不包括混合电路)分规范

IEC QC 001002:1986 IEC 电子元器件质量评定体系(IECQ)程序规则修改单 1(1992)

IEC 748-4-2 中极限值表分为两个部分,为了与已发布的空白详细规范一致,本标准将其合成一个表。

本标准由中华人民共和国信息产业部提出。

本标准由全国集成电路标准化分技术委员会归口。

本标准起草单位:信息产业部电子工业标准化研究所。

本标准主要起草人:李燕荣、陈焱琨。

IEC 前言

1) IEC(国际电工委员会)是由各个国家电工委员会(IEC 国家委员会)组成的世界性的标准化组织。IEC 的目的是促进电工电子领域标准化问题的国际合作。为此目的,除其他活动外,IEC 发布国际标准。国际标准的制定由技术委员会承担,对所涉及内容关切的任何 IEC 国家委员会均可参加国际标准的制定工作。与 IEC 有联系的任何国际、政府及非官方组织也可以参加国际标准的制定。IEC 与国际标准化组织(ISO)根据两组织间协商确定的条件保持密切的合作关系。

2) IEC 在技术问题上的正式决议或协议,是由对这些问题特别关切的国家委员会参加的技术委员会制定的,对所涉及的问题尽可能地代表了国际上的一致意见。

3) 这些决议或协议以标准、技术报告或导则的形式发布,以推荐的形式供国际上使用,并在此意义上,为各国家委员会所认可。

4) 为了促进国际上的统一,各 IEC 国家委员会应有责任使其国家和地区标准尽可能采用 IEC 标准。IEC 标准与相应国家或地区标准之间的任何差异应在国家或地区标准中指明。

本标准 IEC 748-4-2 由 IEC/TC47(半导体器件)的 SC47A(集成电路)制定。

本标准是 IEC 电子元器件质量评定体系(IECQ)范围内的线性模拟/数字转换器(ADC)空白详细标准。

本标准文本以下列文件为依据:

六个月法	表决报告
47A(CO)271	47A(CO)282

表决批准本标准的详细资料可在上表列出的表决报告中查阅。

在本标准封面的 QC 编号是 IEC 电子元器件质量评定体系(IECQ)的规范号。

本标准引用下列 IEC 标准:

IEC 68-2-17:1978 环境试验 第 2 部分:试验——试验 Q 密封修改单 4(1991)

IEC 747-1:1983 半导体器件 分立器件和集成电路 第 1 部分:总则

IEC 747-10:1991 半导体器件 第 10 部分:分立器件和集成电路总规范

IEC 748-1:1984 半导体器件 集成电路 第 1 部分:总则 修改单 1(1991)

IEC 748-4:1987 半导体器件 集成电路 第 4 部分:接口集成电路 修改单(1991)

IEC 748-11:1990 半导体器件 集成电路 第 11 部分:半导体集成电路(不包括混合电路)分规范

IEC 749:1984 半导体器件 机械和气候试验方法 修改单 1(1991)

IEC QC 001002:1986 IEC 电子元器件质量评定体系(IECQ)程序规则 修改单 1(1992)

中华人民共和国国家标准

半导体器件 集成电路

第 4 部分:接口集成电路

第二篇:线性模拟/数字转换器(ADC)

空白详细规范

GB/T 18500.2—2001
idt IEC 748-4-2:1993
QC 790304

Semiconductor devices—Integrated circuits—
Part 4:Interface integrated circuits—
Section 2:Blank detail specification for linear
analogue-to-digital converters(ADC)

引言

IEC 电子元器件质量评定体系遵循 IEC 的章程并在 IEC 授权下进行工作。该体系的目的是确定质量评定程序,以这种方式使一个参加国按有关规范要求放行的电子元器件无需进一步试验而为其所有参加国同样接受。

本空白详细规范是半导体器件的一系列空白详细规范之一,并且与下列 IEC 标准一起使用。

IEC 747-10/QC 700000 半导体器件 第 10 部分:分立器件和集成电路总规范

IEC 748-11/QC 790100 半导体器件 集成电路 第 11 部分:半导体集成电路(不包括混合电路)
分规范

要求的资料

本页和后面方括号内的数字与下列各项要求的资料相对应,这些资料应填入相应的栏中。

详细规范的识别

- [1] 授权发布详细规范的国家标准化机构名称。
- [2] 详细规范的 IECQ 编号。
- [3] 总规范、分规范的编号及版本号。
- [4] 详细规范的国家编号、发布日期及国家标准体系要求的其他资料。

器件的识别

- [5] 主要功能和型号。
- [6] 典型结构(材料、主要工艺)和封装资料。
如果具有若干种派生产品,则应指出其差别,例如用对照表列出特性差异。
如果器件属静电敏感型,应在详细规范中附加预防说明。
- [7] 外形图、引出端识别、标志和/或有关外形的参考文件。
- [8] 按总规范 2.6 的质量评定类别。
- [9] 参考数据。
[本规范方括号给出的条款仅供指导详细规范的编写,而不纳入详细规范中。]
[当某一条款指导编写可能引起混淆时,应在括号内说明。]